

VAC 645/665

Expert en Technologie de Refusion Phase Vapeur

Fours de Refusion Phase Vapeur sous Vide pour une qualité de brasage optimale

IBL



Les fours de refusion VAC 645 et VAC 665 (disponibles en batch ou en ligne) garantissent une qualité de brasage optimale et sans voids. La technologie phase vapeur combinée au procédé de vide (versions i) accroît de façon significative la fiabilité du produit fini. Le brasage est réalisé sous atmosphère inerte tout au long du processus de refusion et de vide. Les nombreuses fonctionnalités brevetées offrent une grande flexibilité dans les process.

Généralités

- 2 versions pour différentes tailles de cartes
- Faible encombrement au sol
- Module de vide flexible intégré
- Voids < 2%
- Brasage sans oxygène ni apport de gaz N²
- Pas de surchauffe des composants
- Faible consommation électrique

Equipment Standard / Spécifications

- Facilité de pilotage avec écran tactile
- Chargement entrée / sortie automatisé
- Mémorisation jusqu'à 50 programmes
- Large gamme de profils de brasage ajustables
- Faible consommation de fluide caloporteur avec conception 2-chambres et système de récupération de fluide
- Système de refroidissement intégré ventilé
- Maintenance et usure minimales (tous éléments mobiles hors zone vapeur)
- 4 canaux internes pour une mesure de température et un profilage optimisés
- Système de gestion d'énergie
- Niveau de fluide contrôlé
- Filtrage automatique du fluide

Caractéristiques techniques

- Procédé de refusion en phase vapeur sous vide pour un brasage sans voids (**breveté**)
- 2 process possibles en 1 phase vapeur : avec ou sans vide
- Pilotage automatique de la pression de vapeur
- IPS, Système Intelligent de Profilage, pour :
 - Profils régulés en température (SVTC : Soft Vapor Temperature Control),
 - Mode piloté, paramétrage et profilage en une seule étape
- Brasage plomb et sans plomb avec un seul fluide pour différentes températures maximum (pic de refusion)
- Logiciel de profilage intégré
- Mode Syncro (panier chaud/panier froid)
- Système transport sans maintenance (**breveté**)
- Facilité d'accès à la chambre vapeur

VAC E-02032015 FR.doc

VAC 645/665

Expert en Technologie de Refusion Phase Vapeur

IBL

Fours de Refusion Phase Vapeur sous Vide pour une qualité de brasage optimale

Options

- Système Refroidissement Rapide (RCS) (**breveté**)
- Système élément chauffant IR (**breveté**)
- Logiciel VP-Control pour paramétrage, enregistrement et analyse de données process
- Ensemble PC complet intégré
- Barcode pour changement automatique de programme, traçabilité et stockage illimité
- Voies supplémentaires de mesure de température process
- Mode multi-niveaux pour changement aisé des différentes hauteurs de brasage
- Système anti-brouillard (AFS) pour une vision claire du process de refusion (**breveté**)
- Adaptateur pour refusion de cartes PCB double face
- Module de puissance secouru (onduleur)
- Chargement en ligne
- Groupe froid autonome



Données techniques	VAC645 / VAC645i	VAC665 / VAC665i
Largeur du four (batch / en ligne)	1355 mm / 2040 mm	1355 mm (2040 mm)
Longueur	2400 mm / 3040 mm	2810 mm (3450 mm)
Hauteur	1470 mm	1470 mm
Poids	1030 kg /1290 kg	1200 kg (1450 kg)
Hauteur chargement / déchargement.	900 - 1000 mm (modèles en ligne)	
Taille maximum des cartes (chargement manuel / batch)	635 x 444 x 70 mm	635 x 644 x 70 mm
Taille maximum des cartes (en ligne)	630 x 400 x 55 mm	630 x 400 x 55 mm
Remplissage du fluide caloporteur	40 kg	60 kg
Raccordement eau	1/2" / 2,5-5 bar / 2,5l/min	1/2" / 2,5-5 bar / 3l/min
Puissance max. de chauffe	10,4 kW	13 kW
Puissance consommée	5,5 kW/h	5,8 kW/h
Alimentation électrique	400/230 VAC, 50Hz, 11 kW	400/230 VAC, 50Hz, 16 kW
Fusible principal	32A, Typ "gL" ou "C"	
Module de vide externe L x l x h, poids	960 x 610 x 1100 mm, 105 kg	

- sous réserve de modifications techniques

VAC E-02032015 FR.doc